

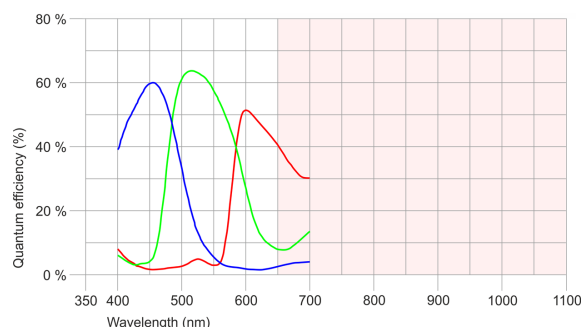
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	ローリングシャッター / グローバル開始シャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	6 MP
有効画素数	6.41 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	3088 x 2076 ピクセル
アスペクト比	3:2
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/1.8"
撮像面積	7.411 mm x 4.982 mm
光学センサーの対角	8.93 mm 1/1.8"
画素サイズ	2.4 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX178LQJ-C
ゲイン (マスター/RGB)	16x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ピンニング水平	増加したフレームレート
ピンニング垂直	増加したフレームレート
ピンニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ピンニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング)水平	-
デシメーション(サブサンプリング)垂直	-
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



モデル

フレームレートフリーランモード	17 fps
フレームレートトリガー（連続）	18 fps
フレームレートトリガー（最大）	17 fps
露出時間（最小～最大）	0.031 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	60043 ms
ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン）	996 1/s
1フレームあたりのライン数（ラインスキャン）	8000
消費電力	1.8 W - 2.7 W
画像メモリ	128 MB

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

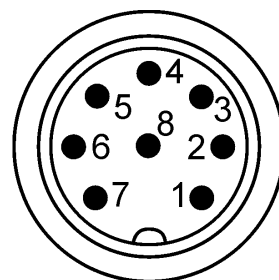
動作時の許容デバイス温度	-20 ° C - 55 ° C / -4 ° F - 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	0 % - 100 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE M12、ねじ止め式
I/O コネクター	Binder 製 8 ピンコネクター (Binder シリーズ 712:09-0427-020-08)
電源	12 V ~ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクター

1	オプトカプラありのトリガー入力 (+) - Line 0
2	入力電源 (VCC)、12 ~ 24 V DC
3	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
4	接地 (GND)
5	オプトカプラありのフラッシュ出力 (+) - Line 1
6	オプトカプラありのフラッシュ出力 (-) - Line 1
7	オプトカプラありのトリガー入力 (-) - Line 0
8	汎用入出力 (GPIO) 2



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP66, IP67, IP69, IPx9K
外形寸法	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量	173 g
ハウジング素材	アルミニウム

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	✓
Long exposure	✓
Line scan	✓
Global start	✓

フラッシュ

Flashing	✓
PWM flashing	✓

画像調整

Auto exposure	✓
Auto gain	✓
Auto whitebalance	✓
Color correction	✓
Gamma	✓
LUT	✓
Mirror/flip	X/Y

統合画像処理

Pixel formats	Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	✓
Decimation (Sensor)	
Binning (FPGA)	✓
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

その他

IP settings	✓
Bandwidth management	✓
Chunks	✓
Sequencer	–
PTP	✓
Firmware update	✓
1st supported firmware version	2.10